

半导体集成电路专用 KKJ-A 型 开壳机

KKJ——A 型集成电路开壳机是我公司与山东省科学院海洋仪器仪表研究所和青岛理工大学联合开发的、专门用于金属封装的集成电路盖板拆除的专用设备。具有完全知识产权，可以取代同类进口设备。

该设备具有操作简单、易于掌握、定位精度高、运行稳定等特点，适用于科研院所、大专院校的相关专业、集成电路生产商以及军工企业的光电器件、光通讯器件、厚膜电路、激光泵浦等采用平行缝焊工艺封装的器件的开壳。开壳是非破坏性的，故能够满足在集成电路的研发、生产和维修等环节中(如无特别规定)的维护后重新封装。

该设备针对金属封装的集成电路的特殊封装工艺，采用了独特的定位和夹紧设计方法，完全能够保证微小零件（4×4mm）的可靠开壳；采取了真空吸尘的方法，确保加工灰尘不进入腔体内部。

设备采用计算机 PID 控制，运行平稳，无震动、无冲击。

主要功能

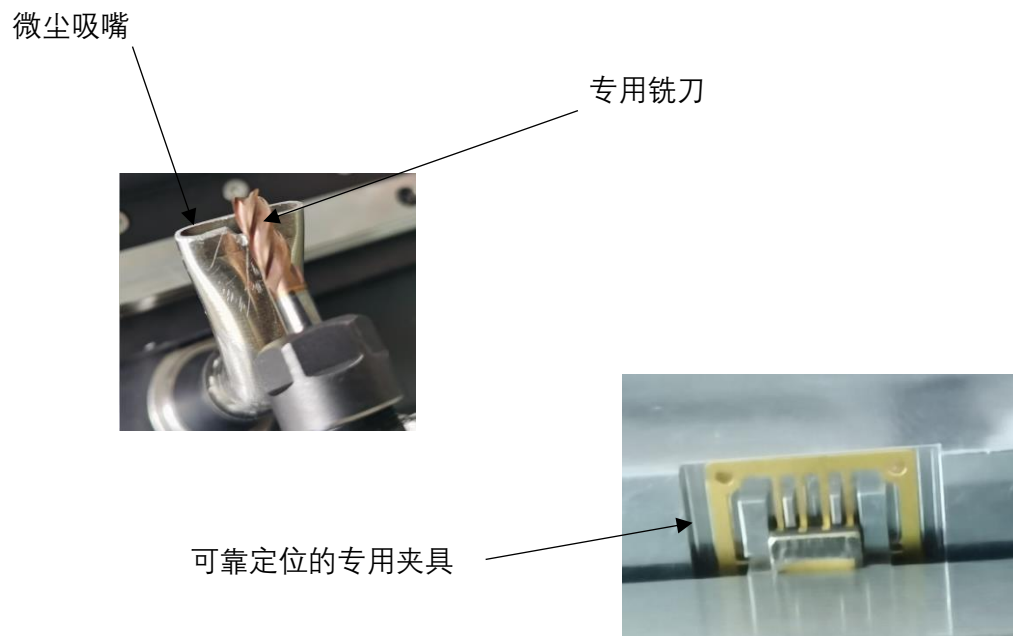
- 1、可对盖板边缘厚度小于 0.5mm 的集成电路实现无尘开壳。
- 2、零件尺寸的设定功能（4~160mm）。
- 3、铣切指标的优化功能（进给速度和切削速度可调）。
- 4、加工微尘吸附功能。
- 5、故障报警功能。
- 6、人体危害防护功能。

主要技术指标

- 1、电源：AC220V 1KW
- 2、开壳零件形状：矩形
- 3、开壳零件尺寸：（4*4）~（50*50）mm 高度小于 20mm

可根据用户需求单独设计

- 4、Z 向铣切深度：0.05~0.5mm
- 5、X 向铣切宽度：0~2mm
- 6、Z 向铣切调整精度：0.01mm
- 7、铣刀旋转速度：1000~5000 转/分
- 8、铣切进给速度：1~12mm/分



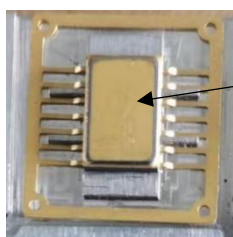


专门用于检测开壳效果的高倍率显微镜

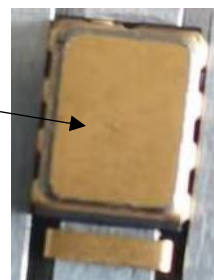
显示器

镜头

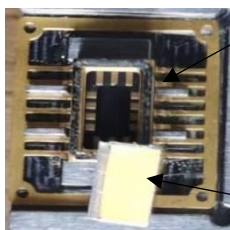
开壳实例



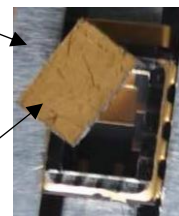
开壳前



开壳后



开壳后盖板



本设备具有独特的夹具设计，微小壳体的开启非常可靠，国内首家！

确保开壳后腔体内无任何污染！

我公司可根据用需要专门设计。